



**El NPM-W2 combina la colocación precisa de componentes, la inspección precisa de SPI y AOI y la dispensación de adhesivo reproductivo en una solución de alta velocidad.**

## **NPM-W2**

Una mayor productividad y calidad gracias a la integración de los procesos de impresión, colocación e inspección hacen del NPM-W2 una de las soluciones de recogida y colocación más flexibles y versátiles del mercado.

### **Key Features**

---

Equipado con un cabezal de 12 boquillas y puede colocar 38.500 componentes

---

Inspección automática de depósitos de soldadura y componentes según los datos de producción

---

Compatible con el mecanismo de descarga HDF, que garantiza una dispensación sin contacto de alta calidad con un dispensador de válvula de tornillo



## NPM-W2

<https://latam.connect.panasonic.com/mx/es/productos/smart-factory-solutions/npm-w2>

<b>PCB dimensions (mm)</b>	Single-laneBatch mounting2-positin mountingDual-laneDual transfer (Batch)Dual transfer (2-position)Single transfer (Batch)Single transfer (2-position)
<b>Placement Head max Speed</b>	38 500cph (0.094 s/ chip)
<b>Placement Head Placement Accuracy (Cpk<math>\geq</math>1)</b>	$\pm 40 \mu\text{m}$ / chip
<b>Placement Head</b>	16 / 8 / 3
<b>Component dimensions</b>	03015 chip ~ L 120 × W90 × T30 / T40 or L 150 × W25 × T30 / T40
<b>PCB Transfer Lane</b>	Single/Dual
<b>Component Supply</b>	Taping/Stick/Tray
<b>Maximum number of components supply (Tape Width: 4 mm, 8 mm calculation)</b>	120
<b>Number of heads</b>	2
<b>Footnote Description</b>	*The above specifications are standard specifications. Please contact us for details, as the product may differ depending on usage conditions, etc.